

## 【Phrozen樹脂 使用者指南】

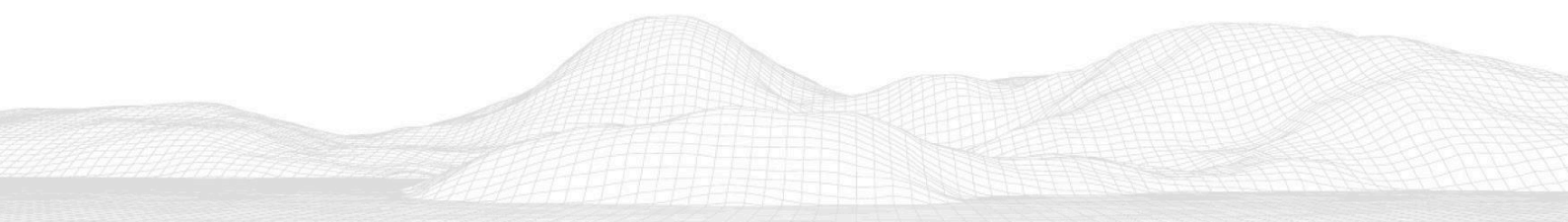
# 工程樹脂：耐高溫樹脂TR300 ,灰色

### 大綱

在列印一個理想的物件前，我們可以先了解材料在各條件下能完整列印出物件的極限在哪；因此**Phrozen**提供以下設計建議，幫助您列印物件時大幅提升成功率，並印製出更符合您心目中的物件。

### 目錄

<b>Sec 1 : TDS</b> .....	1
<b>Sec 2 : 列印</b> .....	2
列印參數 .....	2
清洗 .....	4
二固 .....	4
<b>Sec 3 : 設計規格</b> .....	5
<b>Sec 4: 應用範例</b> .....	9



## Section 1

### TDS

General Properties	Norm	Typical values		
Appearance	-	Gray		
Viscosity, 30	Cone/Plate Rheometer <sup>1</sup>	110 - 160 mPas		
Density (liquid resin)	ASTM D4052-18a	1.17 g/cm <sup>3</sup>		
Tensile Properties	Norm	Typical values		
		UV post-cured	UV +Thermal (150°C)	UV +Thermal (200°C)
Tensile Strength at Break	ASTM D638	56.5	88.6	87.7
Tensile Modulus	ASTM D638	2745.4	4671.3	4883.3
Elongation at Break	ASTM D638	4.5	2.6	2.2
Impact Properties	Norm	Typical values		
		UV post-cured	UV +Thermal (150°C)	UV +Thermal (200°C)
Notched Izod (Machined), 23 °C	ASTM D256	20.1	31.5	31.8
Thermal Properties	Norm	Typical values		
		UV post-cured	UV +Thermal (150°C)	UV +Thermal (200°C)
HDT at 0.45 MPa	ASTM D648	65	149	160
Hardness	Norm	Typical values		
		UV post-cured	UV +Thermal (150°C)	UV +Thermal (200°C)
Shore D	ASTM D2240	80D	80 - 85D	80 - 85D

\* 所有的性能測試都是以Phrozen Sonic Mighty 8K 或 Sonic Mini 8K列印,並使用 清洗固化組做清洗及二固。

\* 在照光二固化之後額外再加熱150°C / 200°C 持續1小時。

\* 熱固化可提升機械性能,但也將增加不規則形變的機率。

Specimens are printed unless stated otherwise. The information in this TDS, including product recommendations, is based on our current knowledge and experience.

Descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. provided may change without notice and do not establish the product's contractual quality. Request

the relevant MSDS from your supplier or contact Phrozen Tech Co., Ltd at [sales@phrozen3d.com](mailto:sales@phrozen3d.com)

## Section 2

### 列印

#### 列印參數

測試機台	Sonic mini / Sonic mini 4K
Layer Height	50 $\mu$ m
Exposure Time	1.5 - 2.5 s
Bottom Exposure Time	15 - 25 s
Light-off Delay	10 s
Lift Distance	6 mm
Lifting Speed	60 mm/min

測試機台	Sonic Mini 8K
Layer Height	50 $\mu$ m
Exposure Time	1.5 - 2.5 s
Bottom Exposure Time	15 - 25 s
Rest Time After Retract	2 s
Lift Distance	6 mm
Lifting Speed	60 mm/min

測試機台	Sonic Mini 8K S
Layer Height	50 $\mu$ m
Exposure Time	1 - 2 s
Bottom Exposure Time	7 - 15 s
Rest Time After Retract	2 s
Lift Distance	6 mm
Lifting Speed	60 mm/min

測試機台	Sonic Mighty 4K
Layer Height	50 μm
Exposure Time	1.5 - 2.5 s
Bottom Exposure Time	15 - 25 s
Light-off Delay	10 s
Lift Distance	8 mm
Lifting Speed	60 mm/min

測試機台	Sonic Mighty 8K
Layer Height	50 μm
Exposure Time	1.5 - 2.5 s
Bottom Exposure Time	15 - 25 s
Rest Time After Retract	2 s
Lift Distance	8 mm
Lifting Speed	60 mm/min

測試機台	Sonic Mighty 12K(升級套件)
Layer Height	50 μm
Exposure Time	1.5 - 2.5 s
Bottom Exposure Time	15 - 25 s
Rest Time After Retract	2 s
Lift Distance	8 mm
Lifting Speed	60 mm/min

測試機台	Sonic Mega 8K*
Layer Height	50 μm
Exposure Time	1.5 - 2.5 s
Bottom Exposure Time	25 - 35 s
Rest Time After Retract	3 s
Lift Distance	8 mm
Lifting Speed	45 mm/min

測試機台	Sonic Mega 8K S
Layer Height	50 μm
Exposure Time	1 - 2 s
Bottom Exposure Time	20 - 25
Rest Time After Retract	3 s
Lift Distance	8 mm
Lifting Speed	60 mm/min

\* Mega 8K 因拉拔力較大, 須提高固化秒數以增加列印成功率

\* 列印時務必蓋上遮光罩, 以維持樹脂最佳列印狀態

### 清洗、靜置

1. 建議使用Phrozen 後處理設備:「Phrozen Cure & Wash」
2. 使用 Phrozen Wash 水流機, 添加95%酒精, 清洗45-60秒。**請勿在酒精或其他溶劑 (例IPA) 浸泡超過60秒, 有可能傷害物件表面**
3. 空心薄件請務必洗淨內部
4. 清洗後靜置30分鐘即可二固  
\*薄件貼底印製時請小心鏟下, 有可能讓模型變形

### 二固

1. 建議使用Phrozen 二固化設備:「清洗固化組」、「Phrozen Mega Cure S UV後固化燈」等
2. UV二固化 60分鐘後再加熱150°C / 200°C維持一小時。

## Section 3

# 設計規格

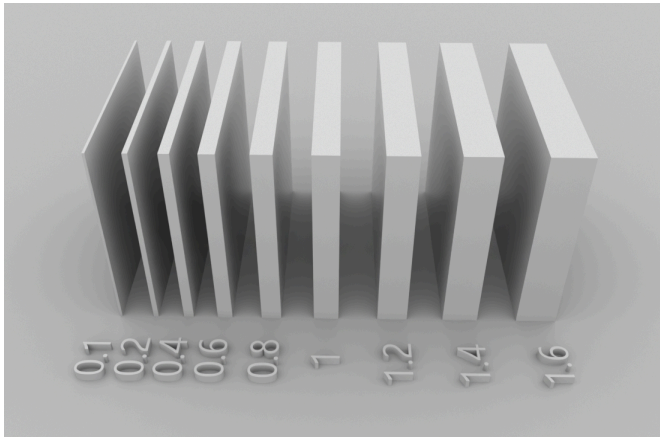
※註：所有指標均為樹脂之極限值，會依照使用機台不同有所差距※

### Minimum Unsupported Wall Thickness

#### 最小無支撐壁厚

此項指標為在無支撐前提下能獨立印出且無彎曲、斷裂現象之最薄厚度。

建議厚度： $\geq 0.4$  mm

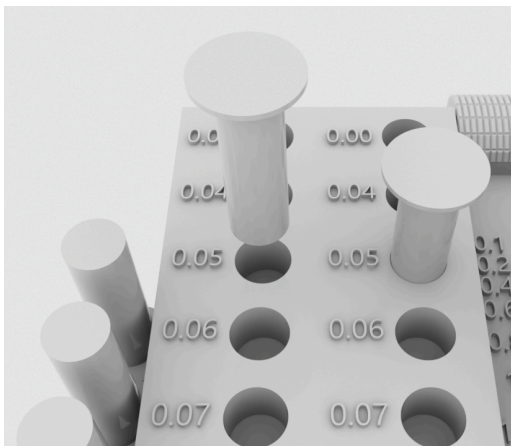


### Size Tolerance, X-Y plane

#### 最小尺寸公差

此項指標為平行於XY平面上的孔洞與立柱接合之最小尺寸公差。

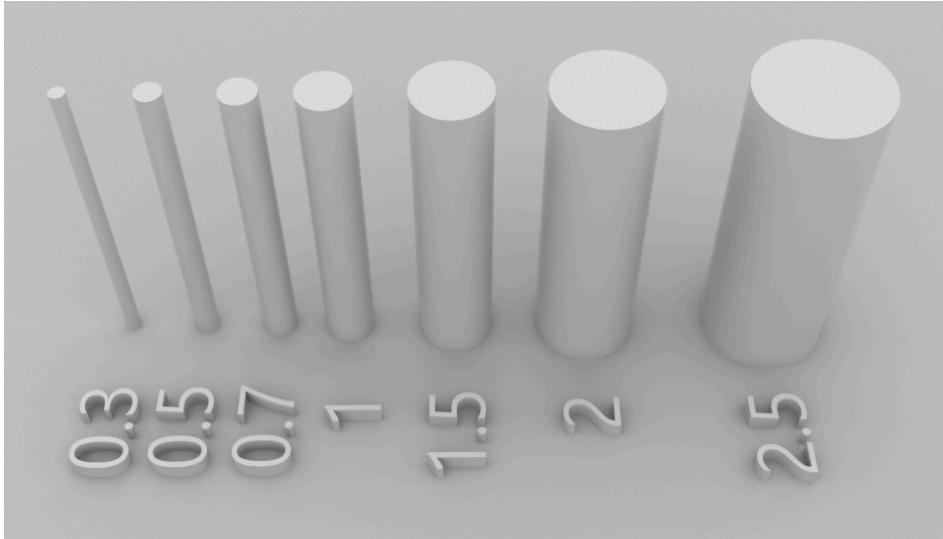
建議公差： $\geq 0.04$  mm



### Minimum Pin Diameter

## 最小立柱直徑

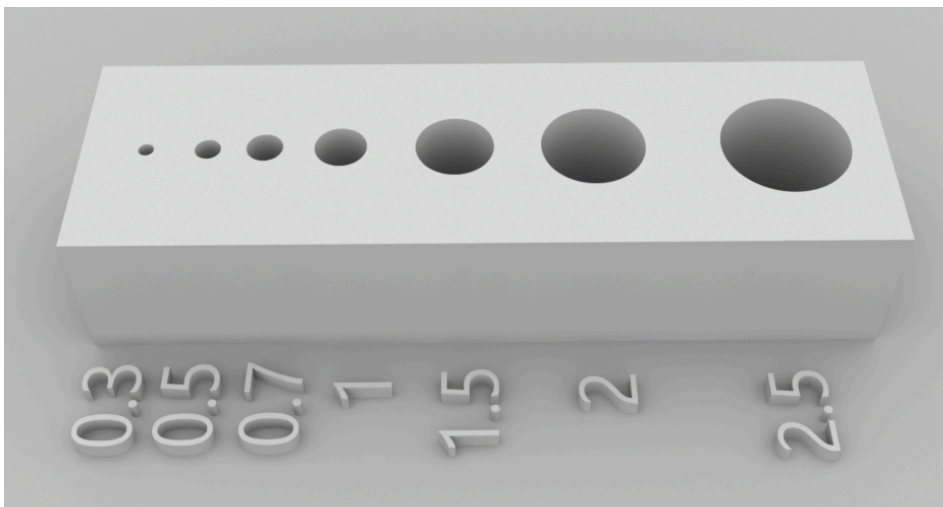
此項指標為細根及支撐能獨立印出且無彎曲、斷裂現象之最小立柱直徑。  
建議直徑:  $\geq 0.7$  mm



### Minimum Hole Diameter, X-Y plane

## 最小孔洞直徑

此項指標為平行於XY平面列印前提下能完整印出之最小孔洞直徑。  
建議直徑:  $\geq 0.7$  mm



### Minimum Embossed Detail Width, X-Y plane

#### 最小浮雕細節寬度

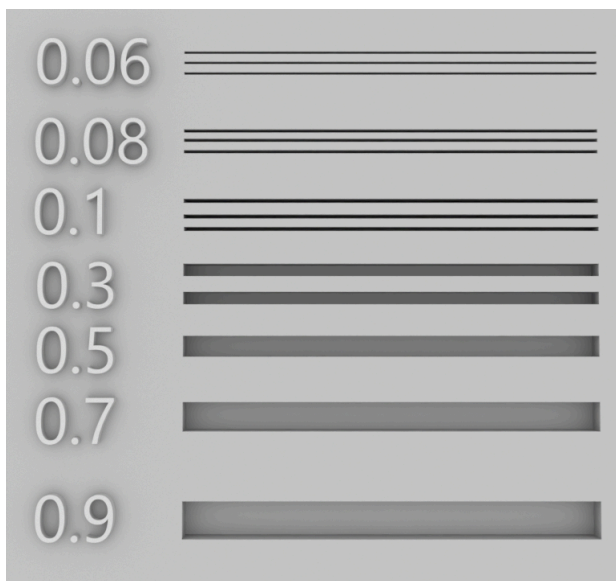
此項指標為可完整列印浮雕細節之最低線條寬度  
建議寬度：≥ 0.1 mm



### Minimum Engraved Detail Width, X-Y plane

#### 最小雕刻細節寬度

此項指標為可完整列印雕刻細節之最低線條寬度  
建議寬度：≥ 0.1 mm

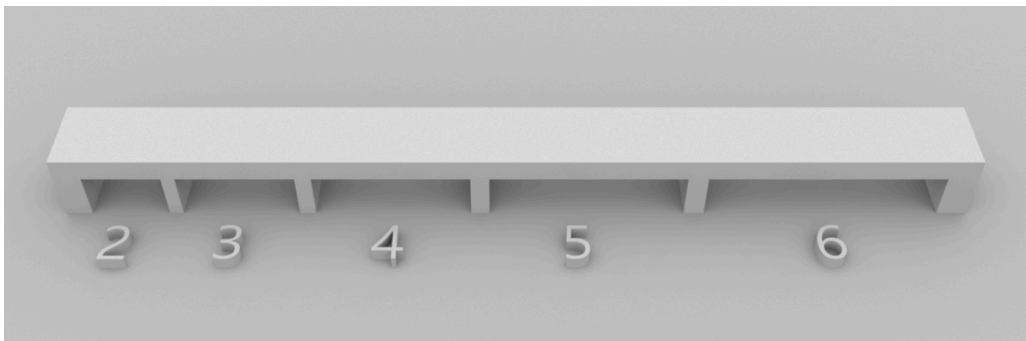




### Maximum Horizontal Bridge Span

## 最大水平跨橋寬度

此項指標為在兩側有支撐壁前提下能印出不變形懸空模型之支撐壁間最大寬度。  
建議寬度:  $\leq 6$  mm



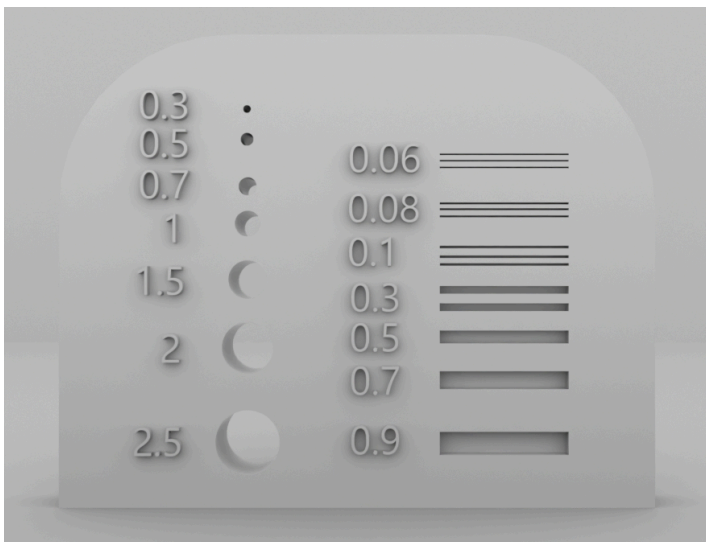
### Minimum Hole Diameter and Engraved Detail Width, Z-axis, at 0.05mm layer height

## Z軸最小孔洞直徑及最小雕刻凹槽寬度 (0.05mm層高)

此項指標為再層厚為0.05mm時Z軸上可完整印出之最小孔洞直徑及最小雕刻凹槽寬度

建議直徑:  $\geq 0.7$  mm

建議寬度:  $\geq 0.06$  mm



## Section 4

### 應用範例

